69日本国特許庁(JP)

①実用新案出票公開

② 公開実用新案公報(U)

平3-38617

動Int. Cl.*
職別紀号 庁内整理番号
母公開 平成3年(1991)4月15日
H 01 G 1/14 A 6736-5E 9/00 3 0 1 7924-5E 13/00 3 1 1 Z 6921-5E B 7039-5E
H 05 K 13/02 B 7039-5E
審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

公考案の名称 電子部品および電子部品連

四代 理 人

弁理士 大原 拓也

②支 職 平1-99507

❷出 顧 平1(1989)8月25日

母 案 者 木 村 野 克 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 エルナー株式会 社内 母考 案 者 大 久 保 哲 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 エルナー株式会

位者 葉 者 大 久 保 哲 伊奈川県最大印江皇前町21日2台1号 エルテー体以3 社内

Ø考 案 者 栗 原 要 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 エルナー株式会 社内

の出 顕 人 エルナー株式会社 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 の出 顕 人 旭 硝 子 株 式 会 社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号



1. 考案の名称

電子部品および電子部品連

2. 実用新案登録請求の範囲

(1) コイン型セルの単体もしくはその複数個を積層してなる電子部品本体の各電極面のそれぞれに対し、回路基板に穿設された取付孔への差込脚を有する一対のリード端子を前記電極面に沿わせた同一方向に取り付けてなる電子部品において、

前記リード端子の端子本体と差込脚の間には、端子本体に対し差込脚を90°変位させるための振り部を介在させるとともに、前記差込脚の下端部には、この差込脚と同一面の横方向に張り出させた支脚部を設けたことを特徴とする電子部品。

(2) 一対のリード端子を各電極面に沿わせた同一方向に取り付けてなる複数個の電子部品を所定間隔でテープ状の台紙に保持させてなる電子部品連において、

210

前記電子部品は、前記リード端子の端子本体と差込脚の間に介在させた振り部を介して端子本体に対し90°変位させてなる差込脚と、この差込脚の下端部にて同一面の横方向に張り出させてなる支脚部とを同一面上に並列配置させて前記台紙に保持させたことを特徴とする電子部品連。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考案は、電子部品および電子部品連に係り、さらに詳しくは、電気二重層コンデンサなどで構成される電子部品連の形成に適合させた縦置実装型の電子部品およびこの電子部品により形成される電子部品連に関する。

[従来の技術]

回路基板などに対する部品実装用自動機への対応性をよくするため、種々の電子部品は、台紙と 粘着テープとを介して形成される電子部品連とし て顧客に納入されている。

ところで、上記電子部品なかには、従来例とし

て第5図に示すリード同一方向型の電気二重層コンデンサ1のような電子部品もある。

このため、リード端子 5 の差込脚 6 相互は、積層されたコンデンサ本体 2 の厚さ b 分だけ離間してしまう結果、これらのリード端子 5 を介してテープ状の台紙に並列させ、これを粘着テープにより仮固定するテーピングと称される包装方式に

よる電子部品連を形成することができず、常に単品構成の集合物として取扱わざるを得ない状況にあった。

[考案が解決しようとする課題]

したがって、第5図として例示した電気二重層 コンデンサ1のような従来タイプの電子品の場合には、電子部品連による一括納入によらずではなけれならず、納品品管理が 気難になるばかりでなく、自動挿入機への では、ボールフィーダを有する部品自動整列 機などの はないた。

[課題を解決するための手段]

この考案は、上記課題を解決しようとするものであり、このうち、電子部品に関する構成上の特徴は、コイン型セルの単体もしくはその複数個を積層してなる電子部品本体の各電極面のそれぞれに対し、回路基板に穿設された取付孔への差込即を有する一対のリード端子を前記電極面に沿わせた同一方向に取り付けてなる電子部品であって、

前記リード端子の端子本体と差込脚の間には、端子本体に対し差込脚を90°変位させるための振り部を介在させるとともに、前記差込脚の下端部には、この差込脚と同一面の横方向に張り出させた支脚部を設けたことにある。

一方、この考案における電子部品連に関する構成上の特徴は、一対のリード端子を各電極面で子を各電極面で子を各電極の電子を各個の電子を移動のでテープ状の台紙に保持させているでは、前記であって、前記電子部品は、前記を登りである。 電子であって、前記電子部品はなるでは、前記であって、前記では、前記では、前記では、前記では、前記では、1000では

[作用]

このため、一対のリード端子におけるそれぞれの差込脚相互は、捩り部を介して同一面に配列させることができるので、台紙に対し粘着テープにより保持させることができ、電子部品連の形成を

容易に行うことができる。しかも、リード端子の 差込脚における下端部のそれぞれには、支脚部が 形成されているので、台紙に対する粘着テープに よる保持状態をより確実なものとすることができ る。

[実施例]

以下、この考案の実施例を第1図ないし第4図 を参照しながら詳細に説明する。

第1図は、この考案に係る電子部品の一実施例を示す全体斜視図であり、同図には、例えば2つのコイン型セル11′、11′からなる電子部品本体を積になる電気二重層コンデン14で被包して外示されている。この電気二重層コンサ11には、一対のリード端子15・15が各電を記して外することで、図示しない回路を振に2・13にかけれての差込脚17・17を各電極に2・13にかせた同一方向に向けて取り付けられている。この場合、前記リード端子15の端子本体16に対し差込脚17との間には、端子本体16に対し差込脚

90°変位させるようにした振り部18が介在形成されており、端子本体16と差込脚17とが十文字状の交差状態となった位置関係をとって形成されている。

このようにして形成されている前記リード端子 15は、電気二重層コンデンサ11の各電極面12、13 のそれぞれに溶接など、適宜の固定手段により取 り付けられており、前記リード端子15における端 子本体16に対し差込脚17と支脚部19とのそれぞれ

は、第2図に示すように同一面上に並列配置させることが可能となっている。

なお、上記実施例における電子部品には、電気 二重層コンデンサのほか、例えばリード端子を同 様に同一方向に引き出してなるボタン型の電池な ども含まれる。

一方、第3図は、この考案に係る電子部品連の一実施例を示す要部拡大図であり、第1図に示けいた電子部品として用りまた場合の電子部品連について示されている。の電子部品連について重要を表すれば、「はり部18を介してテープ状の台紙21の同じに並列配置させたリード端子15の差にの同じに立りに対し、台紙21の幅よりも決にに形成された粘着テープ22を被せて貼り付けることにより確実に保持させて電子部品連が形成されている。

この考案は、上述したようにして構成されているので、この考案に係る電子部品を取扱うに際しては、第3図に示すようにテーブ状の台紙21に対

し一対の前記リード端子15、15の差込脚17、17と 支脚部19、19とをそれぞれ同一平面上に並列配置 することができ、このようにして複数個の電子 品、例えば電気二重層コンデンサ11を配置 むた 後、前記台紙 21より狭幅に形成されている テープ 22を被せて貼り付けて保持させることができる。この場合、台紙 21の側への電気二重層 コンデンサ11の保持状態は、リード端子15、15の差と ンサ11の保持状態は、リード端子15、15のを ンサ11のみならず、支脚部19、19をも含めてより テープ 22により貼り付けられているので、より 定的で確実なものとすることができる。

また、リード端子15のそれぞれは、捩り部18を介して端子本体16と差込脚17とを十文字状の交差状態とすることができるので、回路基板に穿設されている取付孔に対し、その接触部位を多くして挿入配置することができ、ガタッキを少なくして装着することができる。

[考案の効果]

以上述べたように、この考案によれば、縦置実

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この考案に係る電子部品の一実施例を示す全体斜視図、第2図は、その正面図、第3図は、この考案に係る電子部品連の一実施例を示す要部拡大図、第4図は、端子板フレームからリード端子を切り取る際のパターン例を示す要部拡大図、第5図は、従来例を示す全体斜視図である。

- 11… 電気二重層コンデンサ、
- 11 ′ … コイン型セル、 12. 13 … 電極面、

14… 熱 収 縮 性 絶 緑 ス リ ー プ 、

15… リード端子、 16… 端子本体、

17… 差 込 脚 、

18… 捩り部、

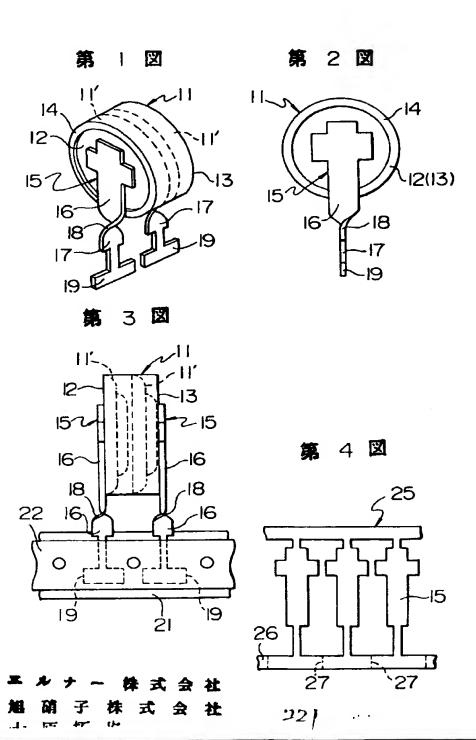
19… 支脚部、

21… 台紙、

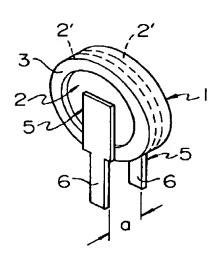
22… 粘着テープ、 25… 端子板フレーム、

26… - 側フレーム部、 27… 切断部

実用新案登録出願人 エルナー株式会社 実用新案登録出願人 旭 硝 子 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 大 原 拓 也



第 5 図



実用新案登録出願人 エ ル ナ ー 株 式 会 社 実用新案登録出願人 旭 硝 子 株 式 会 社 代 型 人 弁理士 大 原 拓 也 整理番号 29-0021

発送番号 407439

発送日 平成14年12月24日 1/2

3/22

拒絕理由通知書

特許出願の番号

平成11年 特許願 第146799号

起案日

平成14年11月29日

特許庁審査官

7509 5R00

特許出願人

株式会社村田製作所様

適用条文

第29条第2項

江畠 博

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

*請 求 項:1~8

*引用文献等:1~3

*備 老:

[請求項1, 2, 3に係る発明]

当該各請求項に係る発明は引用文献1に実質的な記載がある。

(文献1:実用新案登録請求の範囲,各図面)

〔請求項4,5,6に係る発明〕

当該各請求項に係る構成はさらに引用文献2を参照のこと。当該構成要素の記載がある。

(文献2:【特許請求の範囲】【0001】【0002】【0023】~【00 27】各図面)

[請求項7,8に係る発明]

当該各請求項に係る発明はさらに引用文献3に記載の製造方法の記載を参照のこと。



このものにおいて、先端部リード先端部を "ねじる" ことは引用文献 1 から容易に想到できるものである。要するにサーミスタ素子である温度センサの形状に対応しての接触面積確保を勘案して適宜に対応できるものである。

本願発明の実施例においても、図4~5の形状の場合はあえて"ねじる"必要がないが、図3のような電極面積の大きな温度センサにおいては電極面積との接触を確保すべき"ねじる"必要性がでてくることは常識的に推考できる。

(文献3:【特許請求の範囲】【0002】【0015】各図面)

(引用文献等一覧)

- 1. 実願平01-099507号のマイクロフィルム (実開平03-038617号) V
- 2. 特開平08-153601号公報
- 3. 特開平11-126727号公報

先行技術文献調査結果の記録

- 調査した分野 IPC第7版 HO1C 7/02 7/22
- ・先行技術文献
- この先行技術調査結果の記録は、拒絶の理由を構成するものでない。